证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-011

# 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研发平台项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年7月1日。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额为人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目基本情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币891,810,577.60元，其中，超募资金金额为人民币178,269,277.60元。公司募集资金到账后，截至2025年12月31日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2025年12月31日累计投入金额 | 投资进度（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产扩能项目 | 42,298.69 | 25,725.28 | 60.82 |
| 2 | 研发平台项目 | 15,255.44 | 2,711.77 | 17.78 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 13,800.00 | 13,978.98 | 101.30 |
| 4 | 补充流动资金（超募资金I） | 5,346.30 | 5,346.30 | 100.00 |
| 5 | 补充流动资金（超募资金II） | 3,700.00 | 3,609.04 | 97.54 |
| 6 | 补充流动资金（超募资金III） | 5,300.00 | 5,195.43 | 98.03 |
| 合计 | | 85,700.43 | 56,566.80 | / |

注：公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金经董事会决议拟用于补充流动资金，但尚未经股东会审议，故未列示，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

三、本次部分募投项目调整实施进度的情况及原因

（一）本次部分募投项目实施进度调整情况

公司结合项目实际建设开展情况，拟对其达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 原达到预计可使用状态日期 | 调整后达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生产扩能项目 | 2026年7月1日 | 2027年7月1日 |
| 2 | 研发平台项目 | 2026年7月1日 | 2027年7月1日 |

（二）本次部分募投项目调整实施进度的原因

本次拟调整实施进度的募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在项目执行过程中受到近年全球宏观经济波动和不可抗力因素影响，公司根据市场实际情况不断进行调整，项目建设进度较原计划有所延缓，但均在可控范围内。此外，为了优化募投项目布局，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，公司新增江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块作为“生产扩能项目”和“研发平台项目”的实施地点，以打造独立、综合化的生产和研发环境，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。因新增实施地点涉及新地块的规划、设计以及土建工程，故募投项目整体达到预计可使用状态时间较原计划有所延缓。同时在项目推进过程中，为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案，公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代，以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的要求，结合项目实际建设情况和公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年7月1日。

四、对募投项目的重新论证

在原达到预计可使用状态时间（即2026年7月1日），公司预计“研发平台项目”募集资金投入金额无法达到相关计划金额的50%，因此根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.1条的规定，公司对“研发平台项目”的可行性、预计收益等根据目前募投项目实际情况进行了重新论证。具体如下：

（1）项目建设的必要性

公司通过构建多维度研发体系强化企业创新生态，一方面，针对现有研发设施不足的瓶颈，新建专业实验室并配置分子筛真空吸附浓缩实验机、蜂窝材料挤出成型机等先进设备，结合技术人才引进，系统性提升特殊气态分析、气流模拟等核心技术攻关能力，为产品迭代提供底层技术支撑；另一方面，公司通过独立试制产线建设实现研发与生产环节解耦，破解设备共用导致的效率制约，加速新材料、新工艺从实验室到产业化的转化周期；同时聚焦环境治理装备、新型过滤材料、智慧空气解决方案等前沿领域深化研究，依托智能检测设备与多年技术积淀构建多层次技术平台，既精准响应电子、生物医疗等细分市场对净化方案的升级需求，又以差异化技术壁垒巩固行业领先地位，驱动企业向创新驱动型发展模式转型。

（2）项目建设的可行性

公司依托强大的研发技术平台、扎实的研发基础和完备的人才培养体系构建核心竞争力。在技术研发方面，公司与天津大学、大连理工大学、南京航空航天大学等十余所国内外高校及科研机构建立产学研合作，深度参与中国电子学会洁净技术分会（AFS）等全球多个权威行业协会，通过技术交流持续引领空气净化领域创新突破，掌握PTFE熔喷复合材料、MOCVD滤筒、高压静电过滤等核心技术。研发投入方面，公司构建了覆盖材料研发、设备升级、工艺优化的全链条创新机制，自主研发的活性炭改性复合技术、节能电机技术已实现产业化，为工业洁净室、医疗净化等场景提供定制化解决方案。在产品认证方面，公司主导产品均严格对标国内外空气洁净质量标准，并已构建起覆盖全球主要市场的资质矩阵，先后通过了中国3C以及多个国际认证含UL、FM、CE、Eurovent、SEMI、EEC、ETL、PSE、UKCA等一系列国际权威产品认证；同时，公司积极践行绿色发展理念，取得产品碳足迹认证、节能环保认证、环境保护认证等多项可持续发展资质。人才梯队建设方面，公司采用“内部选拔+外部引进”的双轨制，建立多层次培训体系与创新激励机制，技术团队规模超200人，并与马来西亚拉曼大学、合北科技大学等机构形成人才联合培养通道，为技术成果转化和可持续发展提供强有力支撑。

（3）重新论证结论

公司对“研发平台项目”重新做了研究和评估，认为项目建设符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。本次对该项目调整实施进度对预计收益不会产生重大不利影响。公司决定将结合公司战略目标和项目实际情况，继续实施该募投项目。

五、本次部分募投项目延期的影响及风险提示

本次部分募投项目调整实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的适度调整，未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

本次部分募投项目调整实施进度的事项已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设的实际需求，对部分募投项目进行延期。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行延期的事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行延期无异议。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码：688376 公司简称：美埃科技

# 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,093,873.34元，截至2025年末母公司可供分配利润为520,473,675.93元。公司在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，经综合考虑后，公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以方案实施前的公司总股本135,251,944股为基数，计算合计拟派发现金红利20,287,791.60元（含税）。2025年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为16.75%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 美埃科技 | 688376 | 不适用 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | Chin Kim Fai(陈矜桦) | 吴闻、李筠凡 |
| 联系地址 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 | 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 |
| 电话 | 025-52124398 | 025-52124398 |
| 传真 | 025-52123659 | 025-52123659 |
| 电子信箱 | ir@mayair.com.cn | ir@mayair.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

（1）主要业务

公司成立于2001年，二十余年以来始终聚焦于半导体、生物制药、公共医疗卫生等领域的工业级超洁净技术的研发和应用，并将这一技术进一步转化应用于商用人居和工业除尘及VOCs治理等细分市场。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占率水平均领先国产厂商、对标海外标杆企业。公司立足于中国市场，不断向东南亚等半导体新兴产业区域布局，目前已经拥有11个境内生产基地和3个境外生产基地，客户覆盖国内外知名半导体龙头厂商。

报告期内，公司通过在中国香港设立的子公司MayAir HK Holdings Limited收购捷志隆约68.39%的股份进行私有化，收购完成后，公司具备独立向客户提供包括风机过滤单元配套、整机设备、洁净室墙壁和天花板系统在内的洁净室全方位解决方案的技术实力和集成能力，进一步拓展公司在洁净室解决方案这一领域的市场边界，实现产品线的延伸及增强，并互相征展和融入彼此的客户群体。

（2）主要产品

公司主要产品有风机过滤单元、过滤器（初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器、化学过滤器等）、空气净化设备、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备、洁净室墙壁和天花板系统等。

1）风机过滤单元：是洁净室空气净化的关键设备，主要用于半导体、生物制药、新能源光伏、食品加工等行业的洁净厂房及洁净室中，是空气净化的关键设备。装于洁净室的吊顶或洁净区域的上方或侧面，搭配或内置高效/超高效过滤器，提供稳定的洁净气流，通过气流的推出作用和稀释作用将室内污染物高效净化，从而达到高洁净度的要求。

2）过滤器产品：搭配风机过滤单元使用，用来去除空气中的杂质，应用于洁净室中特定工序、洁净室新风系统、暖通系统等。根据用途和洁净效率分为初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器和化学过滤器等。

3）空气净化设备：内置搭配不同的过滤器产品进行销售。可用于生物制药产线（生物安全、无菌净化设备）、室内空气净化（商用、医用、家用空气净化机）、餐饮场景（除油烟净化器）。

4）大气排放治理设备：公司提供系统解决方案，包括粉尘治理系统，油雾净化系统及VOCs有机废气治理系统等。公司现已开发出多系列的粉尘废气治理设备，如干式除尘设备、湿式除尘设备、VOCs浓缩转轮、RTO蓄热式催化氧化设备、除湿转轮及沸石转轮等，用于控制工业生产过程中产生的粉尘、油雾、有机废气等大气污染物质和环境湿度。

5）洁净室墙壁和天花板系统：提供综合洁净室产品及服务，包括开发、生产及安装洁净室墙壁及天花板系统。

图表1：公司主要产品示意图

来源：公司官网

图表2：捷志隆主要产品案例示意图-洁净室墙壁及天花板系统

来源：捷志隆官网

2.2 主要经营模式

（1）盈利模式

公司主要从事空气净化产品、大气环境治理等产品的研发、生产和销售。在业务开展过程中，公司以产品的研发、设计及制造为重心，结合客户的需求及应用场景为客户提供空气净化产品及服务，主要通过直销方式完成销售，实现收入和利润。

（2）采购模式

公司建立有严格的质量管理体系，制定了《供应商控制流程》《采购控制流程》等完善的供应商导入和考核规范。公司主要采用“以销定购”的采购模式。以风机过滤单元和过滤器产品为例，公司采购的主要原材料包括风机、滤材、板材、铝型材、粘合剂等物料。公司根据订单情况安排核心部件采购，非核心的辅助性材料根据价格及市场供给情况定期进行备货。

（3）生产模式

1）生产模式概述

公司产品生产主要根据订单执行，即根据客户订单要求进行产品设计和生产。公司在获得销售订单后，由制造部门根据工程设计及订单情况制作生产计划单，并下达各个生产车间进行生产。生产完工后，公司会对产品进行质量检查，质检合格后，公司包装并安排发货。

2）生产基地情况

报告期内，公司主要拥有11个境内生产基地及3个境外生产基地，具体情况如下：

图表3：公司生产基地

| 生产基地 | 所属主体 | 面积（㎡） | 主要生产产品 |
|---|---|---|---|
| 南京生产基地 | 美埃科技 | 73,044.52 | 风机过滤单元、初中效过滤器、高效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化设备 |
| 中山生产基地 | 美埃中山 | 5,300.00 | 初中效过滤器、高效过滤器 |
| 成都生产基地 | 美埃成都 | 1,914.21 | 初中效过滤器 |
| 天津生产基地 | 美埃天津 | 8,139.41 | 初中效过滤器、高效过滤器 |
| 无锡生产基地 | 美埃无锡 | 3,900.00 | 除尘设备、滤筒、大气治理产品 |
| 美埃环境生产基地 | 美埃环境 | 3,555.00 | 空气净化设备、排污除尘设备、新风设备、油雾净化设备、油烟净化设备 |
| 美埃电子生产基地 | 美埃电子 | 2,000.00 | 微静电过滤器 |
| 美诠环保生产基地 | 美诠环保 | 2,500.00 | 空气净化设备 |
| 南京恩必安生产基地 | 美埃恩必安 | 6,463.44 | 从事VOCs有机废气处理等环保设备的研发、生产及销售 |
| 无锡西沃生产基地 | 无锡西沃 | 7,200.00 | 初中效过滤器、漆雾过滤纸盒、耐高温过滤器 |
| 马来西亚生产基地 | 美埃制造 | 8,837.17 | 风机过滤单元、初中效过滤器、高效过滤器 |
| 加拿大生产基地 | CA | 3,045.26 | 从事滤料和空气净化设备的研发、生产及销售 |
| 捷志隆马来西亚生产基地 | 捷志隆 | 4,515.00 | 从事洁净室墙壁和天花板系统的研发、生产及销售 |
| 捷志隆中国生产基地 | 捷志隆 | 5,200.00 | 从事洁净室墙壁和天花板系统的研发、生产及销售 |

3）外协生产（OEM）

报告期内，公司根据发展的需要，对家用/商用空气净化器、过滤器产品、送风口等相对成熟且标准化的产品采用少量OEM生产以补充产能。同时，对于工业除尘设备等新进入的产品领域，在市场开拓初期，公司采用OEM生产方式实现新品的快速上市，后续根据市场需要和厂房建设情况进行自制产能规划。

（4）销售模式

公司主要的销售模式按照获取方式可分为利用自主品牌公开竞标和客户直接下单。大型项目的客户一般采取招投标方式，公司销售人员根据相关竞标要求制作招标文件参与投标；长期合作的客户，公司一般定期签订框架合同，并根据客户的订单安排发货销售。

公司主要销售模式按照是否为最终客户可分为直销、经销。公司直销模式为主，直销模式客户主要系净化项目业主方或承包方，主要通过自主品牌公开竞标和客户直接下单，占比较大。经销模式客户主要采购替换备品备件，主要通过公司销售团队推广获取订单和客户直接下单，主要采用买断式经销，占比较小。

2.3 所处行业情况

（1）、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

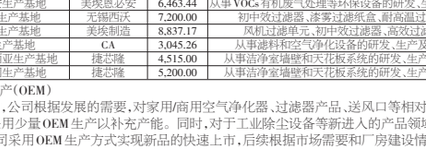
（1）行业的发展阶段和基本特点

公司所处的是空气洁净行业，以半导体领域为例，洁净室是下游制造核心环节。洁净室是一种控制空气中微小颗粒、有害气体和微生物等污染物的特殊空间，可以在室内控制温度、湿度、压力、气流速度和方向、噪音、电磁干扰、微振动、照度和静电等因素，以达到特定需求下所规定的洁净度等级。洁净室被广泛应用于电子、半导体、制药、生物医学、光学与航空航天等领域。

洁净室的主要原理为利用流体力学的相关性质来控制室内污染源，通过内部搭载高效/超高效过滤器的风机过滤单元，提供稳定的洁净气流，通过气流的推出作用和稀释作用将室内污染物高效净化，从而达到高洁净度的要求。

公司构建了高效的全球供应链体系，通过对风机、滤材滤料、板材和型材等关键原材料的精准采购与协同开发，确保了产品品质的源头领先。公司致力于关键材料的自主可控，多项核心前沿材料由公司自主研发与合作伙伴联合开发，目前主要材料已实现国产替代，打破了国外技术垄断。在材料技术领域，公司针对纳米纤维及改性活性炭建立了深厚的技术护城河。依托浸渍型化纤滤材改、分子筛应用、活性炭高效吸附及离子交换纤维等核心技术，公司通过精准的酸洗工艺，独家改性剂配方及严苛的浸渍比控制，使产品性能显著超越行业标准。公司通过精益制造，形成过滤器产品具备灵活性的商业模式，即可作为核心零部件集成系统设备，亦可作为独立终端产品外销。公司的核心竞争力不仅在于单一产品，更在于基于对材料学与应用技术的深度挖掘，为客户提供具有竞争力的空气净化全场景综合解决方案。公司产品广泛应用于洁净室空气净化、室内空气品质优化及大气污染治理三大领域。凭借深厚的技术积淀，公司在洁净室这一高技术门槛领域的国内市场占有率持续领先，已成为公司最核心的收入来源。

图表4：公司产品产业链上下游




国际标准ISO14644是洁净室的洁净等级标准，根据每立方米中不同粒径颗粒的数量，评定相应的ISO1~9等级。其中，ISO1级为最高洁净等级，建设及维护成本相对最高，ISO9级为洁净室的最低等级，公司的产品可以满足ISO1级最高洁净等级的空气洁净要求。各下游应用领域对于洁净室的空气洁净等级要求均有不同。半导体及电子行业，制造特定产品需要无尘且温湿度适当的环境；医药行业及食品行业，制造过程需要无尘、无菌及无真菌的受控环境，且需控制及预防受污染的制造产品外流。

对于半导体行业来说，洁净室是制造环节中重要的一环，直接影响产品良率。集成电路产业链几乎所有的主要环节、IC制造的前后道工序都需要在洁净室中完成，如果生产过程中空气洁净程度达不到要求，产品良率会受到很大影响。洁净室污染物包含气态分子（AMC）和固态颗粒（particle），其中AMC包含酸性气体（MA）、碱性气体（MB）、可凝结物（MC）、掺杂物（MD）及其他未分类物。相关污染物超标会导致硅片腐蚀、光刻胶T-topping、Footing、厚胶缺角、光刻机镜片雾化、掺杂浓度失控、硅片破裂等后果，影响产率与良率。国际半导体技术路线图（ITRS）针对不同制程工艺节点所需洁净室污染物均提出了明确的控制要求。IC制造过程对洁净程度要求越来越高，或将推动洁净设备技术迭代，从而利于半导体洁净行业蓬勃发展。同样，洁净室设备对于显示行业的制造过程也很关键。

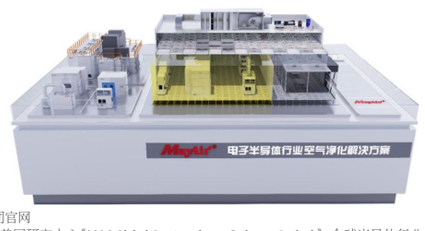
半导体洁净厂房通常采用垂直单向流的方式，通过推出作用将室内污染的空气排至室外，从而达到净化室内空气的目的。洁净室空气净化主要分为三个阶段：

第一阶段，使用初中效过滤器进行预处理：通过空调控制温湿度，同时通过其中搭载的过滤器对室外进入室内的新风进行预处理，拦截空气中常见的大颗粒物。该环节的设备位于洁净室（生产车间）物理隔离层壁板外部，预处理完成的空气将进入洁净室壁板内部。

第二阶段，使用风机过滤单元进行深度过滤：风机过滤单元（含高效/超高效过滤器、化学过滤器等）位于洁净室内部，满布于洁净室（生产车间）物理隔离层内部的顶端，对第一阶段预处理后的空气中未能处理的其他细微颗粒物、气态分子污染物、微生物进行进一步处理，以达到半导体生产车间的空气极高净化等级要求。

第三阶段，内部空气持续循环：洁净室内部空气循环净化，回风通过高架地板及回风夹道，送至风机过滤单元（含高效/超高效过滤器、化学过滤器等）重新过滤后送入洁净室内重复使用。

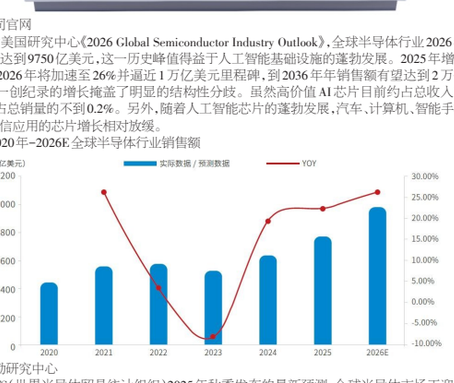
图表5：半导体洁净厂房的主要结构示意图




来源：公司官网

根据德勤美国研究中心《2026 Global Semiconductor Industry Outlook》，全球半导体行业2026年年销售额预计将达到9750亿美元，这一历史峰值得益于人工智能基础设施的蓬勃发展。2025年增长达到22%，预计2026年将加速至26%并逼近1万亿美元里程碑，到2036年年销售额有望达到2万亿美元。然而，这一创纪录的增长掩盖了明显的结构性分歧。虽然高价值AI芯片目前约占总收入的一半，但它们仅占总销量的不到0.2%。另外，随着人工智能芯片的蓬勃发展，汽车、计算机、智能手机及非数据中心通信应用的芯片增长相对放缓。

图表6：2020年-2026E全球半导体行业销售额



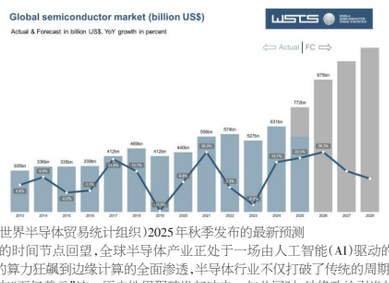

来源：德勤研究中心

根据WSTS（世界半导体贸易统计组织）2025年秋季发布的最新预测，全球半导体市场正迎来史诗级的增长周期。由于2025年第三季度业绩远超预期，WSTS显著上调了年度增长目标，预计2025年全球半导体市场将录得22%的强劲增长，销售额调增至7,720亿美元。这一上调主要归功于生成式AI的爆发及数据中心基础设施的持续扩容，其中逻辑芯片（Logic）与存储芯片（Memory）成为核心动力，同比增速分别高达37%和28%。

从产品结构看，市场呈现出明显的“结构性分化”。在逻辑与存储芯片高歌猛进的同时，模拟芯片、传感器及微处理器等领域则处于温和复苏阶段，增速维持在4%至10%之间；而受汽车市场需求疲软的影响，分立器件领域表现相对乏力。地域方面，受益于AI算力需求的集中爆发，美洲与亚太地区预计将实现25%至30%的跨越式增长，成为全球市场的增长极，而欧洲与日本市场增速则相对保守。

展望2026年，全球半导体行业有望迈向1万亿美元的历史性里程碑。WSTS预测2026年市场增速将进一步加速至25%以上，总产值预计达到9,750亿美元。届时，增长动能将从AI领域扩散至全行业，所有产品类别及地理区域均有望实现扩张。逻辑与存储芯片预计将连续第二年保持30%以上的高速增长，而欧洲与日本也将摆脱低迷，步入两位数增长轨道。这种持续的高景气度不仅反映了算力时代的刚需，也将深度驱动先进制程设备及超高标准洁净室环境的需求迭代。

图表7：2013-2028年全球各地区半导体市场份额




来源：WSTS（世界半导体贸易统计组织）2025年秋季发布的最新预测

站在2026年的时间节点回望，全球半导体产业正处于一场由人工智能（AI）驱动的深刻变革中心。从数据中心的算力狂飙到边缘计算的全面渗透，半导体行业不仅打破了传统的周期性波动规律，更在2026年正式向“万亿美元”这一历史性里程碑发起冲击。与此同时，地缘政治引发的供应链重构与国产替代的深化，正迫使制造端向7nm及以下先进制程加速演进。作为支撑精密制造的物理基石，洁净室行业在技术标准与市场规模上也随之迎来双重跃迁。

综上，WSTS和SEMI对于预测总结如下：

一、全球视野：资本开支迈入景气扩张长周期

受生成式AI革命及基础设施扩容的深度驱动，全球半导体行业已进入新一轮投资景气周期。

1）总量突破与增速上调：根据WSTS最新预测，由于AI逻辑芯片与存储器的爆发式增长，2025年全球半导体产值已调增至7,720亿美元。预计2026年增速将进一步加速至26%，年销售额预计达9,750亿美元，标志着行业正式跨入万亿市场的前夜。

2）资本开支高位运行：2025年全球半导体行业资本支出约达1,600亿美元。其中，300mm晶圆厂设备支出首次突破1,070亿美元里程碑。SEMI预测，2026至2028年全球300mm设备总支出将达3,740亿美元，行业长期景气趋势明确。

二、中国聚焦：先进制程驱动下的全产业链跃迁

中国半导体产业在政策驱动、市场需求及产业链安全的共同利好下，先进制程的投资比例持续提升。

1）AI芯片市场爆发：国内AI芯片市场规模从2020年的190.6亿元飙升至2025年的1,700亿元以上，5年复合年均增长率（CAGR）高达64.8%。算力需求的指数级增长，倒逼国内制造端加速向7nm以下制程迭代。

2）战略突破与自主可控：根据“十四五”规划，中国正稳步提升半导体设备与材料的国产化率，目标到2030年实现关键环节达到国际先进水平。目前，成熟制程设备已实现规模化替代，未来攻克光刻机、EDA工具等关键短板将是实现全产业链自主可控的核心路径。

三、洁净室行业：高标准驱动下的“价量齐升”

作为半导体制造不可或缺的基础设施，洁净室行业正随制程升级迎来黄金成长期。

1）规模与面积双增：中国洁净室市场规模已由2015年的768亿元增长至2025年的3,080亿元，CAGR达14.65%。同期新建面积增长至4,580万平方米。

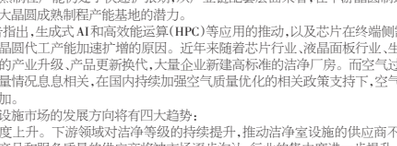
2）技术门槛定义新标杆：随着3nm等极致制程的研发与投产，业主对洁净室的要求已从颗粒控制升级为原子级的分子（AMC）控制。ISO1级最高洁净标准的普及，不仅使单位造价成本持续攀升，也为具备高等级技术储备的净化设备供应商建立了极高的竞争壁垒。

3）下游结构稳固：在电子信息产业国产化扩产浪潮下，半导体应用在洁净室下游占比持续超过50%。尽管医疗卫生需求稳定增长，但半导体产业的高技术投入仍是拉动洁净室市场扩张的核心引擎。

2026年的半导体行业不仅是数字产值的扩张，更是技术边界的突破。随着万亿市场的联动效应，半导体制造的精密化将持续倒逼下游洁净室工程向超高标准转型。具备ISO1级技术服务能力的企业，将在这一轮先进制程的产能博弈中占据绝对的主动权。

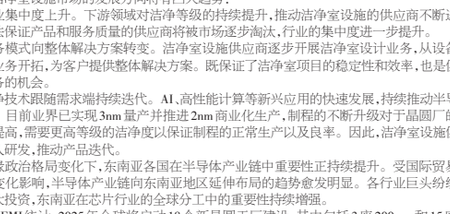
从洁净室工程的下游细分行业来看，电子信息产业中的IC半导体、光电面板等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，洁净室在电子信息类的市场规模增长幅度最大，主要系国产化替代与芯片短缺驱使半导体等电子信息行业扩大产能。医疗卫生事业的发展与医药等行业扩大需求的背景下，半导体行业在洁净室工程的下游应用的占比依然过半且稳定增长，拉动洁净室工程市场规模持续扩张。

图表8：2015-2025中国洁净室工程行业规模及增速




来源：智研咨询，华泰研究

图表9：2015-2025年中国洁净室新建面积及增速




来源：智研咨询，华泰研究

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2025年，全球半导体行业在经历周期性深度调整的同时，也迎来了技术迭代与结构性复苏的战略窗口。面对复杂严峻的全球经济环境和日益加剧的地缘政治风险，半导体行业的发展韧性持续承压。

从宏观形势来看，2025年全球经济复苏动能持续偏弱，整体经济面临显著的下行压力。一方面，受宏观经济疲软拖累，终端消费需求修复不及预期；另一方面，贸易保护主义抬头、关税壁垒升级，地缘政治风险，叠加通胀压力和供应链重构的多重因素交织，致使企业经营面临原材料成本上升、跨境物流受阻、市场需求波动加大等多重挑战。

半导体行业虽在AI算力需求驱动下保持总量增长，但行业利润加速向头部AI芯片企业集中，呈现典型的“K型复苏”格局，多数中小企业增收不增利，结构性分化现象明显。另外地缘政治风险已成为半导体企业经营面临的最大不确定性。与此同时，关税壁垒的持续加码和“去风险化”供应链策略的深入推进，进一步推高了半导体企业的运营风险与成本负担，境外业务拓展面临更大不确定性。在此背景下，半导体洁净室行业虽受益于全球芯片资本开支的持续扩张，但下游企业经营压力的传导效应已开始显现。

在洁净室领域，公司主要的竞争对手以国际品牌爱美克AAF和康奢尔Camfil为主。全球行业竞争较为激烈且分散。这些厂商通过与洁净室相关的主业向洁净室设备领域延伸业务，目前规模普遍不大。

近年来，半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置，半导体行业受到前所未有的政策支持，高科技企业尤其是半导体领域企业的国产化替代进程开始加速，国内的晶圆代工厂、IDM厂商以及封测厂商开始扩建产线与洁净室厂房，风机过滤单元、过滤器等洁净室设备需求持续增长。

中国晶圆成熟制程产能仍处于快速扩张期，从产业链配套层面来看，在洁净晶圆制造环节，中国具备成为全球最大晶圆成熟制程产能基地的潜力。

SEMI的报告指出，生成式AI和高效能运算（HPC）等应用的推动，以及芯片在终端侧需求的复苏，成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、液晶面板行业、生物医药行业及食品加工行业的产业升级、产品更新换代，大量企业新建高标准的洁净厂房。而空气过滤器市场空间与国内空气质量情况息息相关，在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下，空气过滤器行业市场规模迅速增加。

未来洁净室设施市场的发展方向将有四大趋势：

1）行业集中度上升。下游领域对洁净等级的持续提升，推动洁净室设施的供应商不断进行产品迭代。无法保证产品和服务质量的供应商将被市场逐步淘汰，行业的集中度进一步提升。

2）业务模式向整体解决方案转变。洁净室设施供应商逐步开展洁净室设计业务，从设备供应商进行纵向业务开拓，为客户提供整体解决方案。既保证了洁净室项目的稳定性和效率，也是供应商提供增值服务的机会。

3）洁净技术跟随需求端持续迭代。AI、高性能计算等新兴应用的快速发展，持续推动半导体先进制程演进。目前业界已实现3nm量产并推进2nm商业化生产，制程的不断升级对于晶圆厂的洁净度要求持续提高，需要更高等级的洁净度以保证制程的正常生产以及良率。因此，洁净室设施供应商需要持续投入研发，推动产品迭代。

4）地缘政治格局变化下，东南亚各国在半导体产业链中重要性正持续提升。受国际贸易环境和产业政策变化影响，半导体产业链向东南亚地区延伸布局的趋势愈发明显。各行业巨头纷纷在东南亚地区加大投资，东南亚在芯片行业的全球分工中的重要性持续增强。

根据SEMI统计，2025年全球将启动18个新晶圆工厂建设，其中包括3座200mm和15座300mm设施，大部分将于2026至2027年开始运营，其中美洲和日本各有4个项目，中国大陆、欧洲及中东各有3个项目，中国台湾地区2个，东南亚和韩国各1个。

从资本支出分布来看，全球半导体设备市场呈现出“一超多强”的地域格局。中国大陆凭借对产业链自主可控的坚定投入，预计未来数年内每年的设备支出将维持在300亿美元规模，稳居全球第一。

与此同时，在全球供应链重构的浪潮下，美洲地区展现出最显著的增长弹性，其支出预计将从2024年的120亿美元翻倍增长至2027年的247亿美元，这直接对应了其境内多座先进制程晶圆厂的建设高峰。中国台湾与韩国则凭借在2nm及HBM存储领域的领先地位，预计到2027年分别达到280亿与263亿美元的投资规模。日本、欧洲及中东地区也将在政策补贴的利好下，于2027年迈向百亿美元投资门槛。这种全球性的产能扩张，不仅保障了AI时代的算力供给，也为下游洁净室工程及空气净化设备供应商提供了跨地域、长周期的市场红利。中国大陆未来数年半导体资本开支有望